

【特徴】めっき銅表面より低い位置で糊が引き伸ばされた様相の突起

【特征】在低于镀铜面的位置有胶被拉长模样的凸出。

【Characteristics】Conductor projection at the lower level than the plated copper surface that appears to be formed by pressed and spreaded adhesive.

【原因・判断ポイント・発生工程】積層板銅箔面に付着した糊がE Tレジストとなり、積層板銅箔部が残って出来たもの（銅めっき前～E T工程）

【原因、判断要点、发生工序】层压板铜箔表面的胶迹成为ET剂，残留在层压板铜箔表面而引起的（镀铜前～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A portion of copper foil of a CCL is left unetched, since adhesive left on the foil surface acts as etching resist. (Preparing boards for copper plating - etching process)



【コメント】糊の下に残った積層板銅箔が突起になっている
顕微鏡倍率×80

【注釋】胶残留在层压板铜箔下面的凸出
显微镜倍率×80

【Comments】Copper foil of a CCL remaining under adhesive becomes a projection.
Magnification: ×80



【コメント】糊の下に残った積層板銅箔が突起になっている
顕微鏡倍率×80

【注釋】胶残留在层压板铜箔下面的凸出
显微镜倍率×80

【Comments】Copper foil of a CCL remaining under adhesive becomes a projection.
Magnification: ×80



【コメント】糊の下に残った積層板銅箔が突起になっている
顕微鏡倍率×80

【注釋】胶残留在层压板铜箔下面的凸出
显微镜倍率×80

【Comments】Copper foil of a CCL remaining under adhesive becomes a projection.
Magnification: ×80



【コメント】糊の下に残った積層板銅箔が突起になっている
顕微鏡倍率×80

【注釋】胶残留在层压板铜箔下面的凸出
显微镜倍率×80

【Comments】Copper foil of a CCL remaining under adhesive becomes a projection.
Magnification: ×80